



# 深圳市吉宸电子有限公司



技术说明书  
KM1210HK  
低温固化银胶

## KM1210HK

### 产品描述:

KM1210HK 导电银胶是一种单组份低温固化环氧导电银胶。它具有高剪切强度, 低模量的特点;对金属、陶瓷基片、硅芯片、绿油等粘接性好。该产品具有极好的贮存稳定性, 固化温度较低, 离子杂质含量低, 固化物有良好的电学和机械性能以及耐湿热稳定性等优点。

### 典型用途:

产品广泛应用于 VCM 摄像头模组、PCB 板、FPC、集成电路等一些基材或工艺不能承受高温烘烤的导电连接。适用于点胶、蘸胶作业工艺, 能实现低温快速固化, 连接强度高。

### 技术指标:

KM1210系列	项 目	测试方法	性能指标(典型值)
	型号	-	KM1210HK
固化前性能	外观	-	银色膏状
	粘度 @ 25°C (Brookfield DV-II+CP@ 5 rpm)	ASTM D1084-97	12,000 cP
	触变指数 @ 25°C @ (0.5rpm/5 rpm)	ASTM D1084-97	5.5
	细度, μm	0-50μm	<10
	使用寿命 @ 25°C	-	9 小时
	保质期	-	> 6 月 @ -5°C
	固化条件	DSC, 10K/min	90 分钟 @ 80 °C
固化后性能	体积电阻率(Ω*cm)	ASTM-D2397	<0.0008
	剪切强度 @ 25°C	ASTM-D412	> 24 Kg/die
	拉伸强度 @ 25°C	ASTM-D412	> 2500 psi
	导热系数 @ 121°C	ASTM-E1461	6.5 W/mK
	玻璃转变温度° C	DSC, 10K/min	70
	热膨胀系数 <Tg	TMA	55ppm/° C
	热分解温度, °C	TG, 10K/min	>300
适用范围			摄像头模组、其它低温工艺
注意事项	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 打开包裹:收到冰袋包装的银胶后立刻将银胶转移到-5°C冰柜, 以免银胶长时间裸露在常温下导致银胶使用寿命和相关性能下降。</li> <li>2. 贮存:低温导电银胶的贮存温度应高于-5°C。如果在此条件下贮存, 该产品达到半年内可使用。贮存期限指明必须有正确的贮存条件, 不当的贮存将可能造成点胶的困难和固化后银胶品质降低。</li> <li>3. 解冻:使用之前将胶筒竖直放置, 待胶筒或广口瓶解冻到室温, 擦去其外壁的水份, 请参考推荐的解冻时间, 在其未达到室温前请尽量不要开启, 器壁的水份务必擦净。解冻时间 30 克以下:30min; 大于 30 克: 60 min。针筒包装须须搅拌, 瓶装须搅拌 15~30 分钟(注意须上下搅拌以使银粉均匀)。</li> <li>4. 使用:解冻后的胶应尽快转移到点胶设备待用, 并避免引入空气和气泡。因工艺受环境影响显著, 丝网印刷、背胶、蘸胶建议分次加胶且一次加胶在 8 小时内用完, 安装防护罩可降低胶水成分的挥发和隔断空气中粉尘以保证品质。在室温下超出推荐的使用时间将有可能发生银粉/树脂分层, 胶水变粘/变干, 固化后推力减小等问题。如果因工艺特性需要稀释, 请选用 DBE 或二乙二醇丁醚作为稀释剂。</li> <li>5. 包装规格:50cc(50g)、1000cc(1000g)</li> </ol>		

### 应用案例:

